



2025年3月期(2024年度) 決算説明会資料

2025年5月12日
住友バークライト株式会社
代表取締役社長 藤原 一彦



2025年3月期(2024年度) 決算概要

2025年3月期 連結業績（前年との比較）

（金額単位：億円）

	2024年3月期 実績①	2025年3月期 実績②	前年同期比較	
			金額(②-①)	増減率
売上収益	2,873	3,048	175	6.1%
事業利益 ^{※1}	275	308	34	12.3%
営業利益	272	248	-24 ^{※2}	-8.9%
当期利益	218	193	-26 ^{※3}	-11.7%
ROE	7.8%	6.5%	-	-

※1 「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース
「当期利益」は親会社の所有者に帰属する当期利益

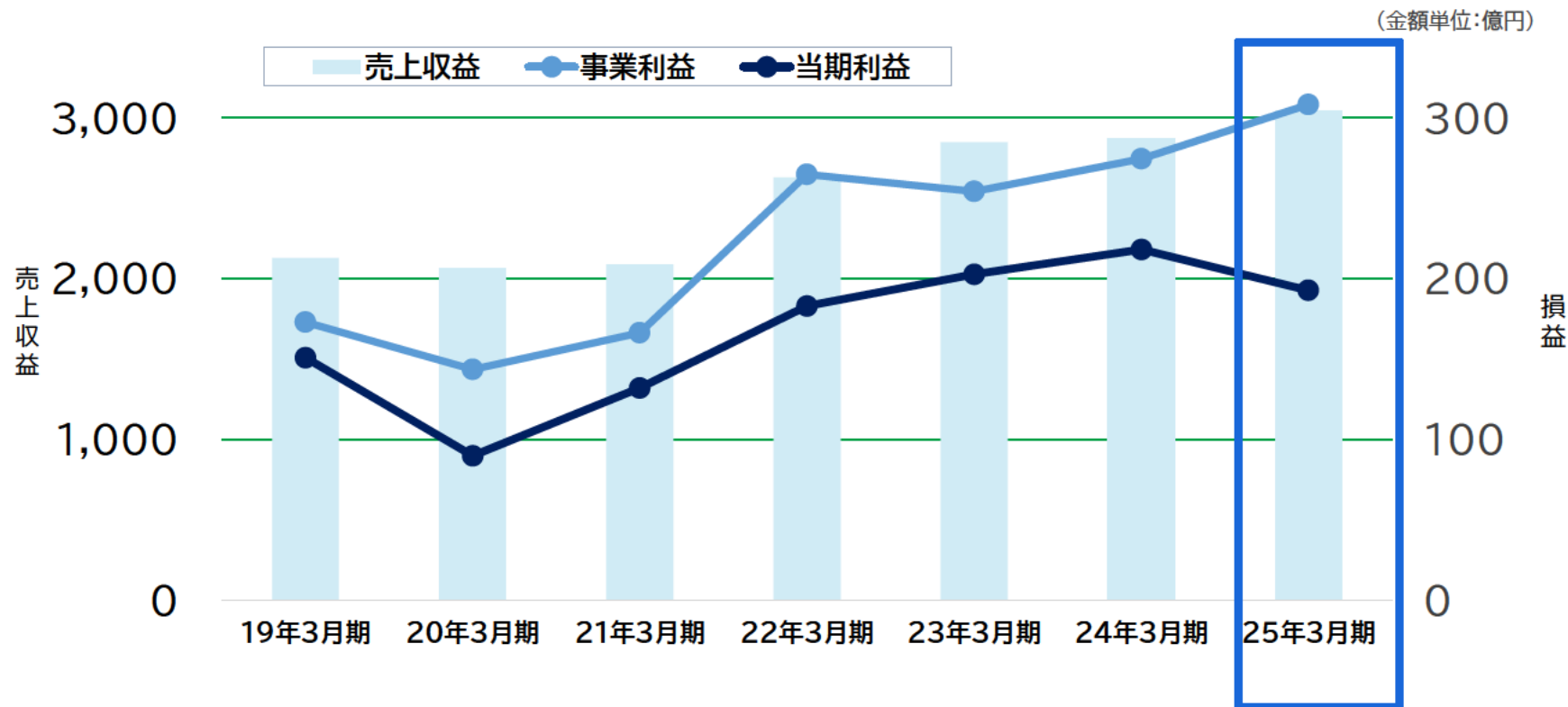
※2 高機能プラスチックの北米フェノール関連子会社の減損や国内外生産拠点の最適化、生産性改善に係る固定資産処分損など 55億円を「その他の費用」に含む

※3 当四半期より海外関係会社からの配当方針を変更したため、それに係る「法人所得税費用」15億円を計上するなど、法人税負担率が上昇

為替レート	2024年3月期	2025年3月期
USD(¥/\$)	144.40	152.48
EUR(¥/€)	156.80	163.62

売上収益・損益（年度推移）

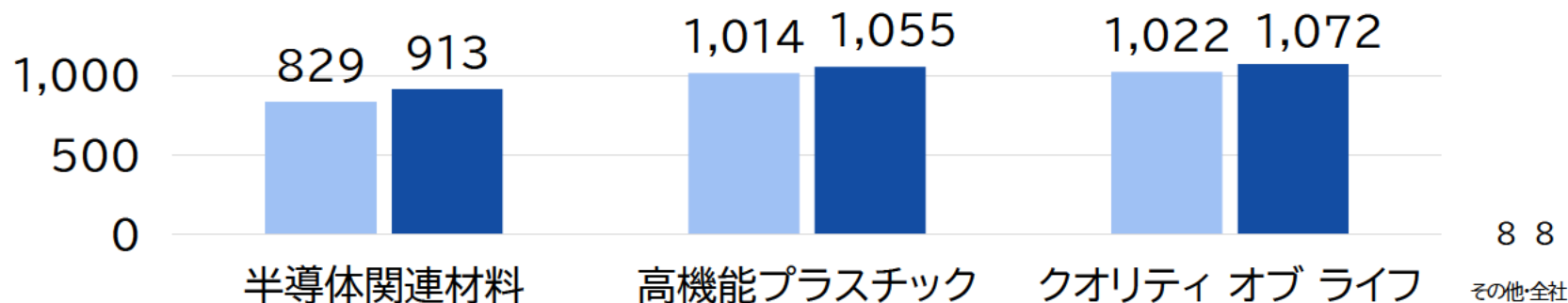
売上収益 3,000億円、事業利益 300億円を初めて超え、過去最高を更新



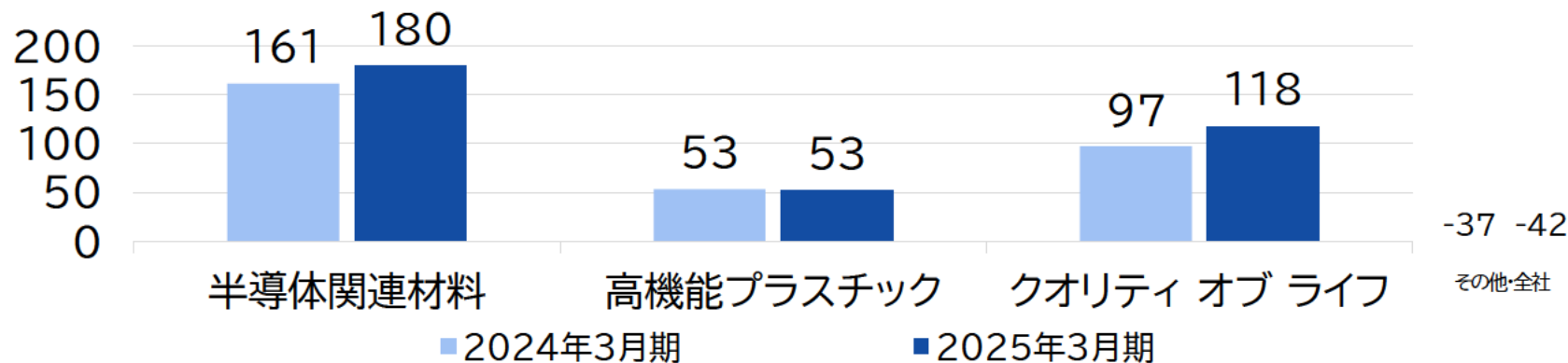
事業セグメント別業績比較

(金額単位:億円)

売上収益



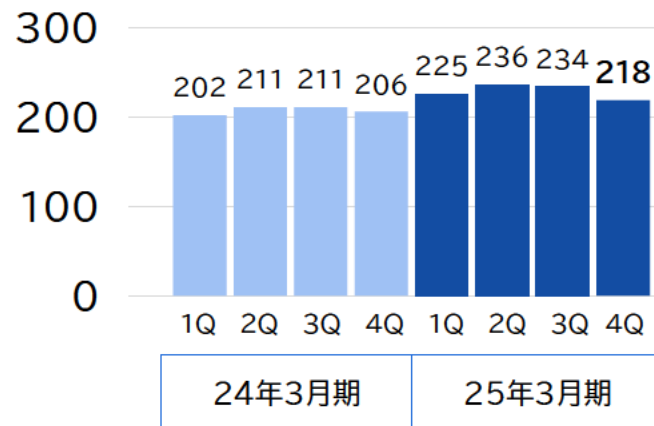
事業利益



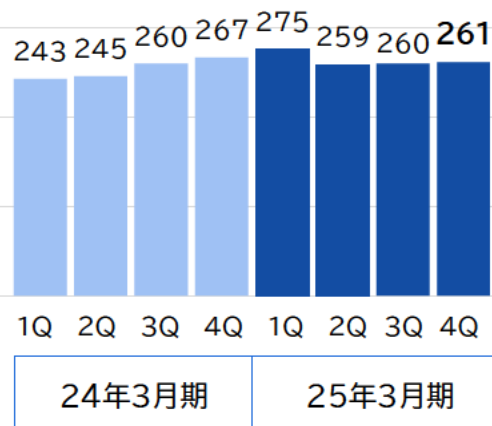
事業セグメント別 四半期販売推移

(金額単位:億円)

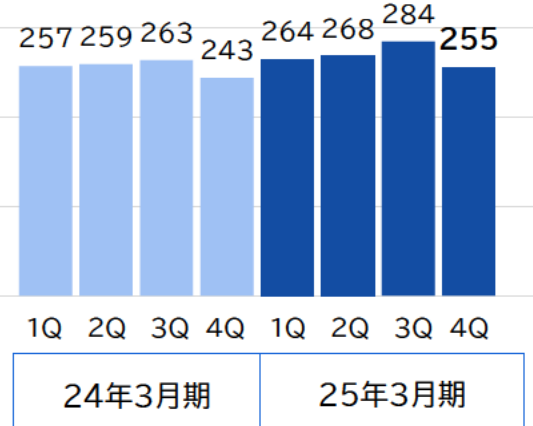
半導体関連材料



高機能プラスチック



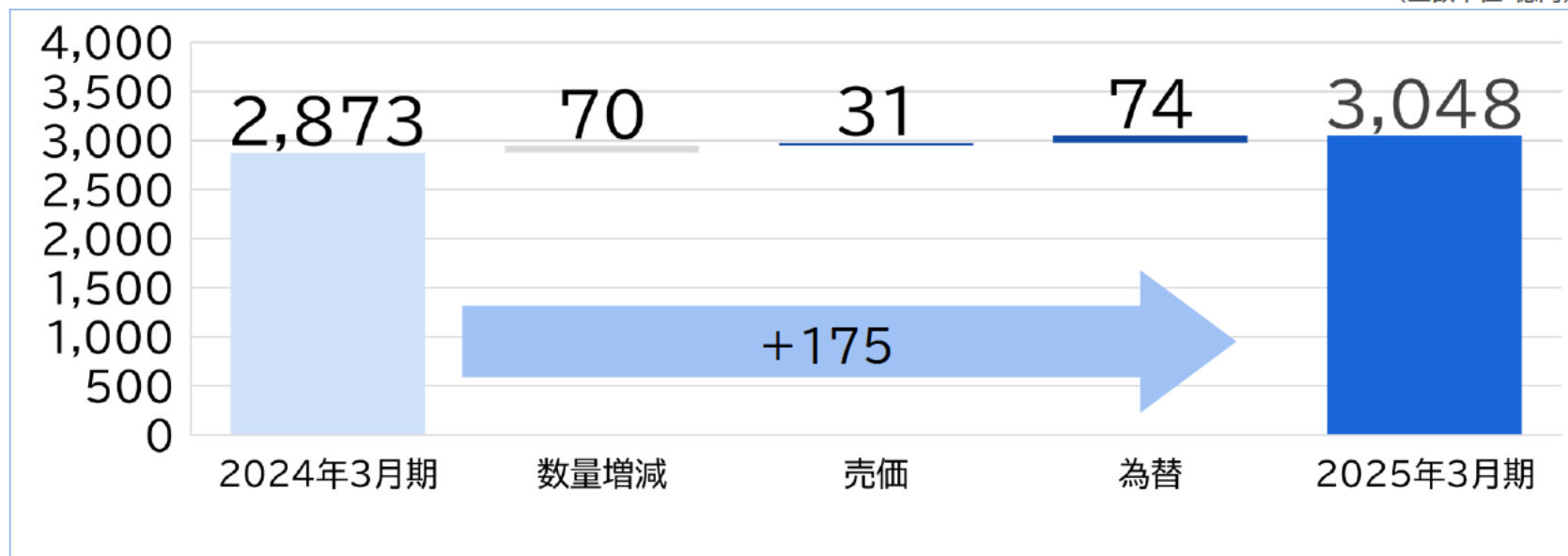
クオリティ オブ ライフ



- 半導体関連材料 : 春節による稼働日減少の影響あるが、中国は高水準を維持
- 高機能プラスチック : 航空機内装品の顧客でのストライキ影響からの復調が進む
- クオリティ オブ ライフ : 季節性要因による減少あるが、基調は変わらず

売上収益増減要因(前年との比較)

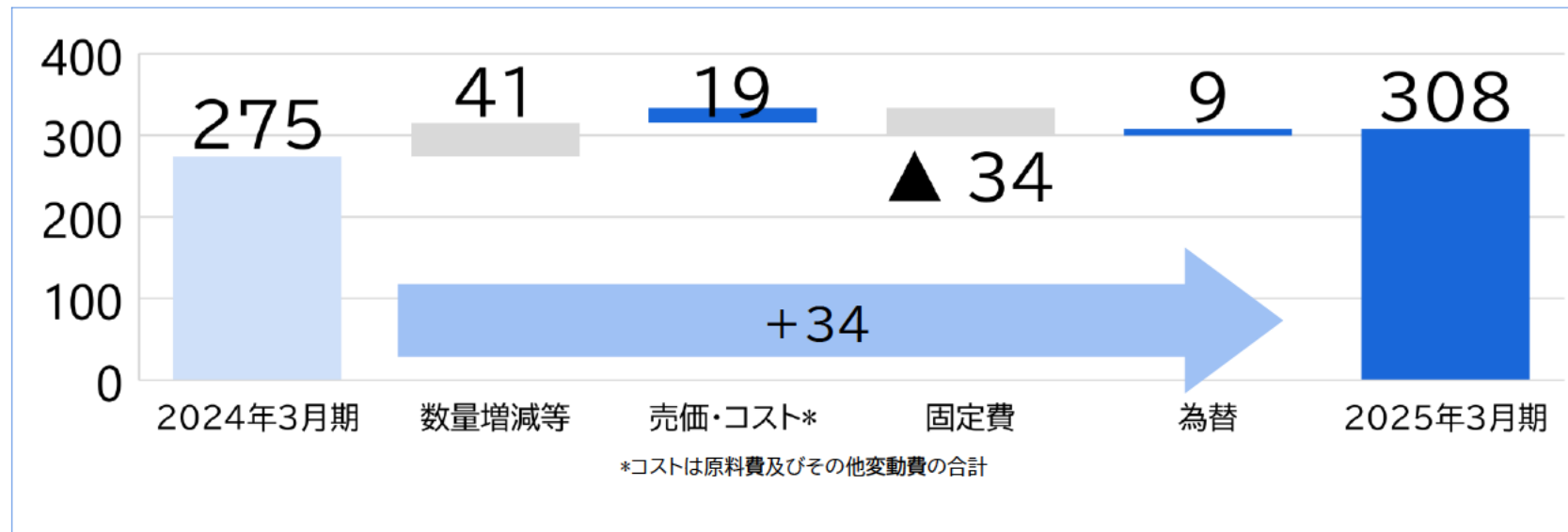
(金額単位:億円)



セグメント別	数量増減	売価	為替	合計
半導体関連材料	46	8	30	84
高機能プラスチック	▲2	7	36	41
クオリティ オブ ライフ	26	16	8	50

事業利益増減要因(前年との比較)

(金額単位: 億円)



セグメント別	数量増減等	売価・コスト*	固定費	為替	合計
半導体関連材料	26	4	▲17	6	18
高機能プラスチック	12	5	▲19	2	▲0
クオリティ オブ ライフ	5	10	4	1	21
その他	▲2	0	▲3	0	▲5



2026年3月期(2025年度) 通期業績予想

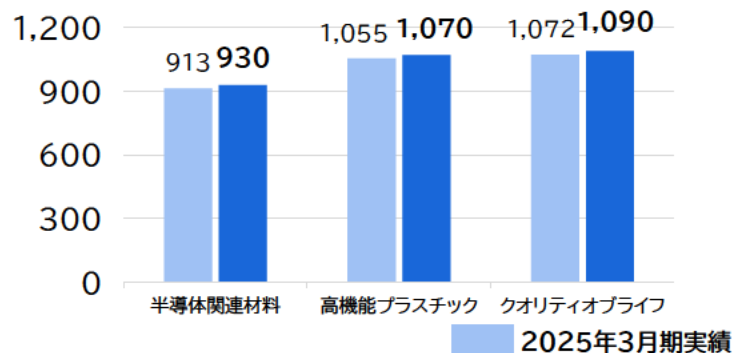
2026年3月期 通期 連結業績予想

(金額単位:億円)

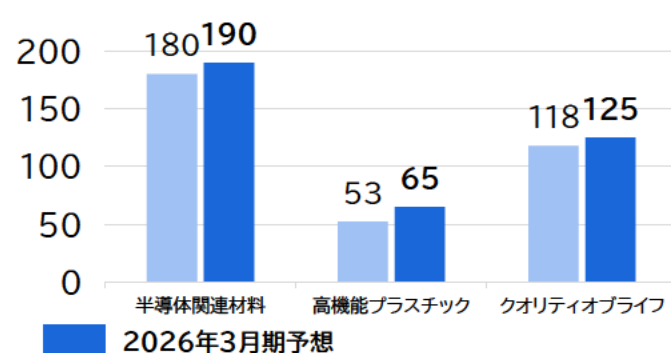
	2025年3月期 実績①	2026年3月期 予想②	前期実績比較	
			金額(②-①)	増減率
為替(¥/US\$)	152.48	143.00	-	-
売上収益	3,048	3,100	52	1.7%
事業利益	308	325	17	5.4%
営業利益	248	310	62	25.0%
当期利益	193	235	42	21.9%

※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース。「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益

セグメント別売上収益



セグメント別事業利益

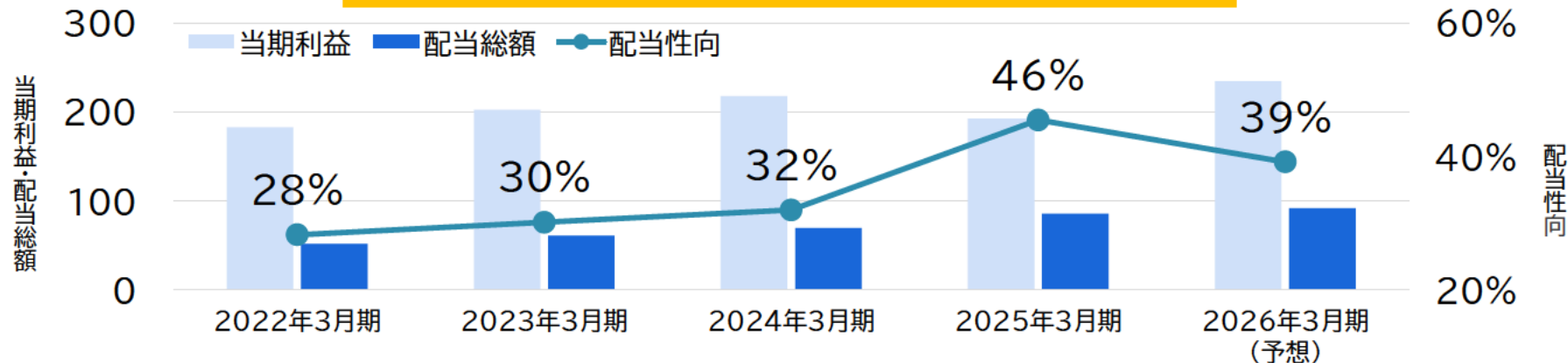


株主還元

■ 年間配当予想: 105円/株 (中間50円・期末55円)

(金額単位: 億円)

1株当たり配当予想は前年度から10円増配



安定的かつ継続的に利益を還元する

配当金(円)/株	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期※1	2026年3月期 (予想)
中間配当	50.00	60.00	70.00	45.00	50.00
期末配当	60.00	70.00	80.00	50.00※2	55.00
年間配当	110.00	130.00	150.00	95.00	105.00

※1: 2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期以前は、当該株式分割前の配当額を記載しております。

※2: 創立70周年(2025年3月1日)記念配当5円を含む。

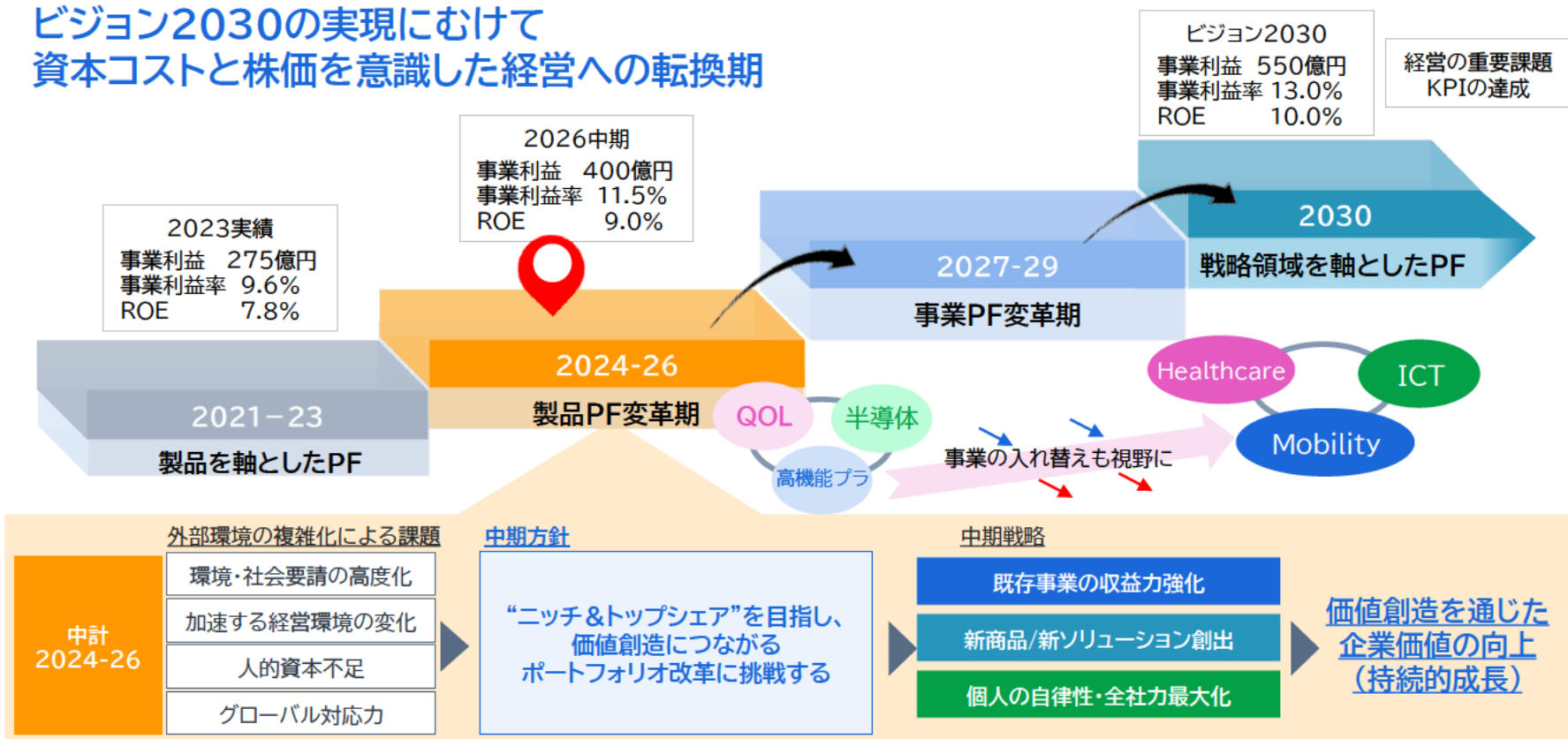


中期経営計画の進捗

中期経営計画2024-26の位置づけ

ビジョン2030の実現にむけて 資本コストと株価を意識した経営への転換期

※PF=ポートフォリオ



経営の重要課題

2030年ありたい姿の達成に向けて、12の経営の重要課題に取り組む



環境・社会価値の創造

カーボンニュートラルへの取組み
・技術・製品開発 ・GHG排出量削減

資源、創エネ／省エネ、長寿命、3R、環境対策
技術開発の推進

GHG排出量

2030年削減目標:48%削減(2021年度比)

2024年度見込み:45%

SDGs貢献

「6+1」の重点領域を設定し、SDGs貢献を推進

SDGs貢献製品 売上収益比率

2030年度目標:70%

2024年度見込み:63.5%

価値創造のアクセラ



顧客との共創



イノベーション



人的資本(人材の活躍)経営



DX

事業を継続する基盤



安全衛生



サイバーセキュリティ



製品責任



人権尊重



コンプライアンス



サステナブル調達



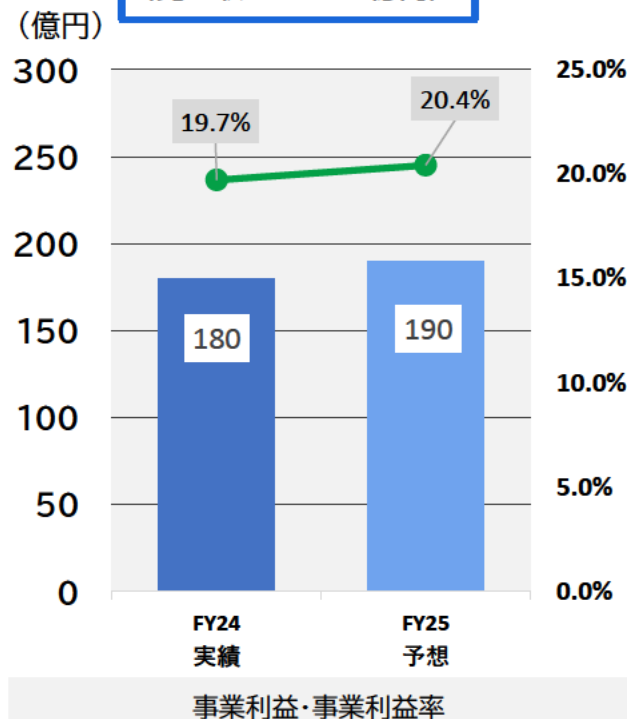
コーポレートガバナンス



各セグメントの振り返りと今期の取り組み

半導体関連材料

2025年度予想
事業利益 190億円
事業利益率 20.4%
(売上収益 930億円)



2024年度の総括

- 中国市場が好調に推移
- 台湾の民生用需要、東南アジアの車載半導体市場は停滞
- モビリティ3製品はHV需要増によりEV減速をカバー
- 次世代AI、パワー半導体用材料の開発を加速
封止材(MUF、顆粒、液状)、TIM、感光材(バッファークート、再配線)、基板材料

*Thermal Interface Material の略

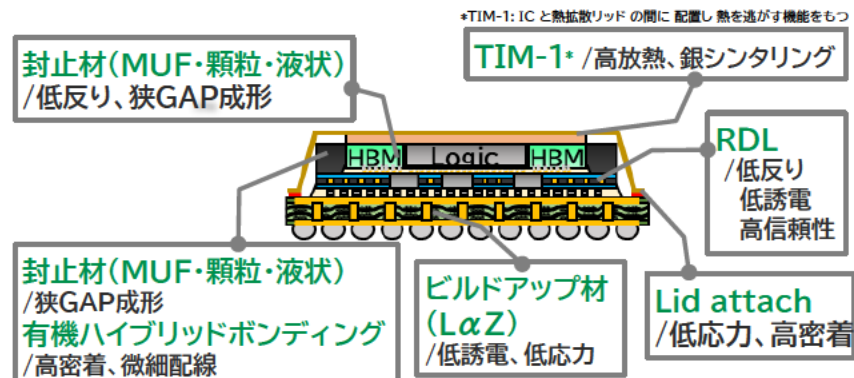
2025年度の見通し、取組み

- 半導体市場は台湾・東南アジアが停滞長期化も中国が伸長継続
- 中国新工場の本格稼働により、需要拡大に対応
- AI関連はMid-Tier(ロボット、ドローン、車載)用が新たに拡大
- 強化領域(AI・パワー・モビリティ)の開発・販売を拡充
外部協業の強化(東北大学との共創研究所等)により開発促進
パワー関連材料開発の専門部署を設置、顧客ニーズに合った製品開発

半導体関連材料【トピックス】

AI半導体向け材料

- ・エッジAI向け MUF、顆粒材、RDL材の拡販
- ・2.5/3Dパッケージ向け材料の開発を強化
HBM、オーバーモールド向け封止材(MUF・顆粒・液状)
高放熱性TIM材
ガラス基板向け低応力ビルドアップ材(LαZ)
HBM用有機ハイブリッドボンディング材
半導体の大型化(PLP工法)向け顆粒材、RDL材



2.5/3Dパッケージの製品ラインナップ

パワーエレクトロニクス向け材料

- ・実績豊富なモビリティ用途から新用途への展開
- ・全社の技術とマーケティング機能を集約した パワーエレクトロニクスソリューション開発部の設置
- ・外部協業、顧客への提案→パワー全領域で開発促進



半導体関連材料【トピックス】

モビリティ

・ステーター用封止材

ロボット分野でも採用・販売開始

オープンラボ活用による開発スピード向上

・一括封止(ECU/TCU、センサーなど)

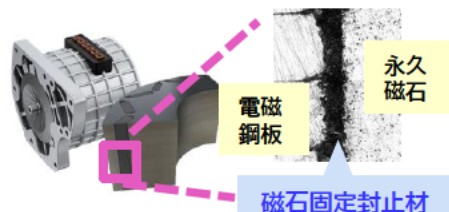
TCUやセンサーなどグローバルに横展開

生産性向上提案として射出成型材料の開発完了

・モーター磁石固定

モーター高速回転化や低耐熱性磁石に対応した
材料開発

永久磁石リサイクル
に適した易解体封止材
の開発



中国市場の伸長

中国の半導体内製化の動きにより、

・NEV市場 ・中華スマホ
・AI関連 ・ロボティクス 等
の市場が急拡大



中国 蘇州の新工場

AI・IoT・ロボティクスを活用した最新鋭の
設備を備える新工場で拡大する需要に対応

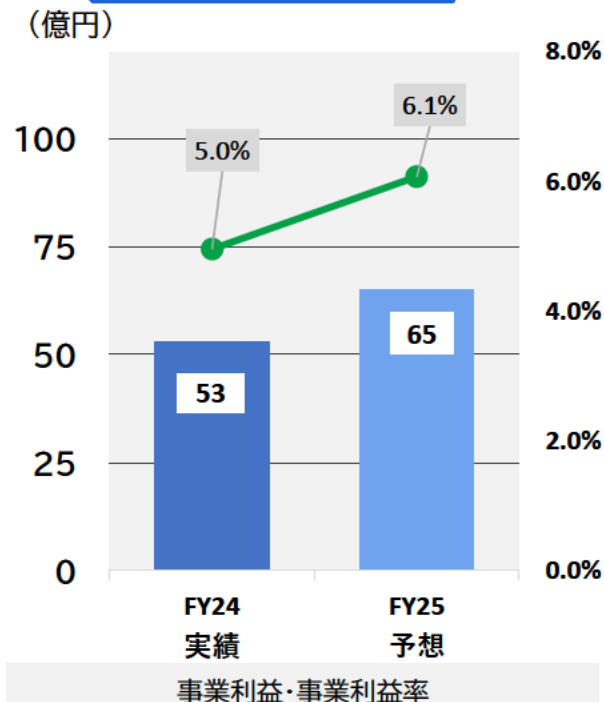
高機能プラスチック

2025年度予想

事業利益 65億円

事業利益率 6.1%

(売上収益 1,070億円)



2024年度の総括

- 中国で最新鋭の自動化設備を備えた新工場が稼働開始
- 構造改革を各地域で着手
北米フェノール関連事業の不採算製品撲滅・身の文化、国内拠点の最適化
- 航空機内装部品事業は顧客ストライキの影響あるも4Qから復調
- 中国でPHEV増加にともない自動車用成形品が好調に推移、
欧州は自動車関連が停滞
- COPLUS®や環境対応材など高付加価値品が実績化

2025年度の見通し、取組み

- 構造改革の成果発現により北米で収益性改善
- 中国、東南アジアは堅調に推移も欧州は横ばい
- 強化領域(半導体用途、航空機内装部品、モビリティ、環境対応)の
販売拡大

高性能プラスチック【トピックス】

高付加価値品へのポートフォリオ変革【強化領域製品の拡販・開発】

電動車（バッテリー、e-Axle、各種電動パーツ）

電動車の進化に対応する高電圧、高耐熱材を開発、サンプル出荷開始

半導体

COPLUS®（シクロオレフィンポリマー）がAI半導体向けで採用
 パワーモジュール向け液状エポキシ注型材のビジネス拡大
 放熱材料も車載用途で実績化。次世代向けも評価進行中

航空機

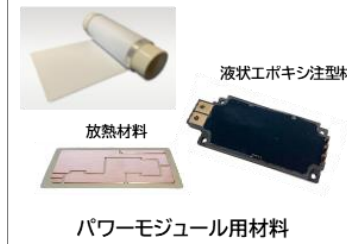
欧州向けカーゴライナーを量産開始。バイオマス材料など積極提案中

環境対応材

超低モノマー水溶性フェノール樹脂が半導体関連用途に採用
 ユーロ7規制対応ブレーキ向け環境対応新製品を顧客に提案開始



COPLUS®の用途が拡大



パワーモジュール用材料



【新たな価値】
 低臭気
 法規フリー
 非防爆

超低モノマー水溶性フェノール樹脂で新用途開拓

クオリティオブライフ関連製品

2025年度予想

事業利益 125億円
 事業利益率 11.5%
 (売上収益 1,090億円)

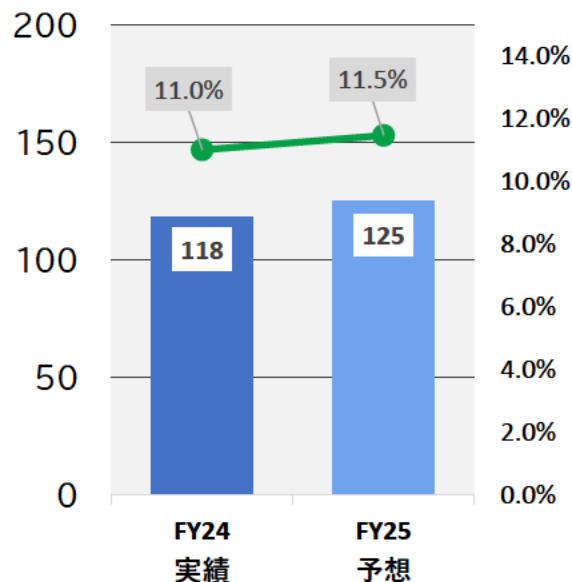
(億円)

2024年度の総括

- 【ヘルスケア】北米で低侵襲医療機器、アジアで血液バッグが拡大
- 【フィルム・シート】中国・アジアの回復・拡販でカバーテープの販売増
- 【産業機能性材料】天候不順の影響により建材用途の販売増
- 【防水関連】住宅向け拡販で過去最高の販売。工事効率化で収益性向上

2025年度の見通し、取組み

- 【ヘルスケア】低侵襲医療機器の拡販を強化。構造改革の実施
- 【フィルム・シート】産業用フィルムの新製品による拡販
- 【産業機能性材料】機能性材料の販売拡大により収益性向上
- 【防水関連】新築住宅・住宅リフォーム向け拡販と工事効率化の推進



事業利益・事業利益率

クオリティオブライフ関連製品【トピックス】

【ヘルスケア】

消化管ステント

胆管・食道・十二指腸・大腸
ラインナップ拡充



十二指腸ステント



大腸ステント

血管マイクロカテーテル

脳領域への拡販を開始

血管マイクロカテーテル



体外診断薬「トリプシン」

膵炎に関する診断薬を
自社開発で初めて商品化

体外診断薬「トリプシン」



【フィルム・シート】

医薬品包装

モノマテリアル材を
欧州市場で評価開始



モノマテリアル材



食品包装(スキンパック)

牛肉・豚肉向け
新規採用拡大



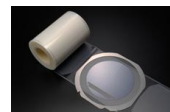
スキンパック

産業用フィルム・シート

カバーテープ、ダイシングテープ新製品
を展開



カバーテープ



ダイシングテープ

【産業機能性材料・防水関連】

車載向け光学製品

グローバルに拡販。
薄型、熱対策、色再現性
の差別化提案を実施



光学シート搭載車載 HUD

車載向け絶縁材

業界最薄品により、
競争優位性を確保



車載向け基板保護
絶縁シート

防水関連

高耐久防水シートや
ソーラーアンカーなど
高付加価値品を拡販



高耐久防水シート上に
施工されたソーラーシステム

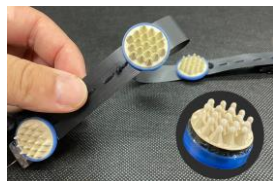
将来を見据えた新規プロジェクト

BMI*事業化プロジェクトチーム

*BMI: Brain Machine Interface (脳波などをセンサーで検知し、外部デバイスとつなぐ技術の総称)

医療、IT、ロボットなどのブレインテック分野で期待される脳波の利用を促すデバイスの開発

- ・2024年度からプロジェクト化
- ・共同開発先とてんかん患者を対象とした臨床研究を推進中
- ・デザイン、使い勝手を考慮した在宅脳波計を開発
- ・2027年度の国内上市を目指す



樹脂製柔軟ドライ電極
(ハイドロゲル使用タイプ)



デザイン、使い勝手を考慮した在宅脳波計



水素製造機能膜量産準備プロジェクトチーム

脱炭素社会に貢献するグリーン水素の低コスト生産を可能にするPFASフリーのイオン交換膜の開発

- ・2025年度からプロジェクト化
- ・設計自由度が高いPNB※を活用※ PNB:ポリノルボルネン(独自素材)
- ・試作品の開発に成功し、水電解装置メーカーで評価開始
- ・2030年度までの量産化を目指す



グリーン水素製造プロセス(当社材は「電解槽」に使用)



水素製造装置用
交換膜 (AEM)

プロジェクトの早期事業化を実現するとともに、
新プロジェクトの追加発足を目指す



SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

<https://www.sumibe.co.jp/>

■ 免責事項について

当社は、本資料の情報がお客様にとって有用なものとなるよう努めておりますが、特定の用途における正確性や妥当性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、関連する用途との適合性や安全性を別途ご検証ください。また、本資料に含まれるいかなる事項も、知的財産権等に関する助言や許可を与えるものではありません。

■ 著作権について

本資料の著作権は、特に断りのない限り、当社またその関連会社に帰属します。当社の許可なく、本資料を無断で複製または転用等を行うことを禁止しております。

■ 会社名の表記方法について

本資料における会社名の表記にあたっては、「株式会社」等の表記を省略している場合があります。